

Cutting Edge

第68期中間 事業のご報告

平成18年4月1日～平成18年9月30日

証券コード：6146



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



DISCOの技術に 触れてください。

p3 — DISCO Feature
精密加工ツールビジネスとディスコの強み

p7 — DISCO Technology
DGP8760 ウェーハ薄化への挑戦

p14 — DISCO Story……③
シリコンサイクルに負けるな!

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって 遠い科学を身近な快適につなぐ」 3つのコア技術を深めることで、 ディスコは産業と人の暮らしに貢献しています。

■ 高度なKiru・Kezuru・Migaku技術とは...

「切る」「削る」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。「Kiru」「Kezuru」「Migaku」とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという想いが込められているからです。

■ 遠い科学を身近な快適につなぐとは...

科学は日々進歩しています。しかしどれほど進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いを込めています。

■ ディスコが追い求める成長とは...

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダとの価値交換を通じ、長期にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。ディスコはそんな企業でありたいと考えています。

Contents

- 2 株主の皆様へ
- 3 DISCO Feature
特集 精密加工ツールビジネスと
ディスコの強み
- 5 DISCO News
- 6 DISCO Business
- 7 DISCO Technology
- 8 DISCO Values
- 9 中間連結財務諸表
- 11 財務指標(連結)
- 12 株主アンケート結果
- 13 会社情報および株式の状況
- 14 DISCO Story... 3

To Our Shareholders

株主の皆様へ

当中間期の経営環境と業績および通期の見通し

半導体市場は2005年春頃から回復局面を辿っており、当中間期におきましても、PC、携帯電話、携帯型音楽プレイヤー等の需要拡大を受けて引き続き好調に推移しました。特にDRAM、NAND型フラッシュメモリといったメモリ市場の伸張が著しく、各半導体メーカーで積極的な設備投資が行われました。

このような経営環境の中当社では、システム・イン・パッケージ（SiP）やNAND型フラッシュメモリ等の高密度実装デバイスの高需要を受けて、薄化関連装置を中心に売上が増加しました。また、消耗品ビジネスである精密加工ツールも堅調に売上を伸ばし、当中間期において過去最高の売上高を更新いたしました。

以上の結果、当中間期の連結売上高は前年同期比38.0%増加の398億25百万円、経常利益は97.0%増加の95億13百万円、中間純利益は142.2%増加の55億59百万円となり、前年同期比で大幅な増収・増益を達成することができました。

下期におきましても、BRICsを含めたグローバルな市場拡大、また携帯型音楽プレイヤー等半導体搭載製品の裾野の広がりによる半導体メーカーの旺盛な設備投資の継続が予測されます。

当社ではこのような市場環境に基づいた顧客からの活発な受注を見込み、通期連結売上高は過去最高の850億円、経常利益197億円、当期純利益108億円を見込んでおります。



代表取締役社長
溝呂木 斉

配当について

最重要政策のひとつである株主様への利益還元につきましては、前期より採用しております連結配当性向20%をベースに、中間配当金は1株当たり30円（前中間期は1株当たり15円）とさせていただきます。

当社は2010年の「あるべき姿」として定めたDISCO VISION実現に向けて、短期的市場動向に一喜一憂することなく着実に歩みを進めてまいります。

株主の皆様におかれましては、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2006年12月

代表取締役社長

DISCO Feature

特集：精密加工ツールビジネスとディスコの強み

精密加工ツールビジネスの強化でシリコンサイクルに対応

半導体業界には、シリコンサイクルと呼ばれる需給のアンバランスから生じる好不況の波があります。精密加工装置は、顧客にとって設備投資となるためサイクルの影響を受けます。一方、精密加工ツールは、精密加工装置に装着して使われる消耗品です。このためシリコンサイクルの中にあっても安定的な出荷が期待でき、過去15年の売上をみても年率10%強の成長を遂げています。ディスコ独自の高い技術力によって生み出される精密加工ツールは競争力も高く、当社の業績の下支えとなり、売上高以上に大きな意味を持つ製品です。

シリコンサイクルと精密加工ツールの売上推移



※半導体市場：1990年を100として指数化 ※出所：WSTS

【精密加工ツールとは】

精密ダイヤモンド砥石に代表される精密加工ツールは、シリコンウェーハやセラミックスなどを「Kiru (切る)」ダイシングブレード、「Kezuru (削る)」グラインディングホイール、「Migaku (磨く)」ドライポリッシングホイールなどに大別されます。創業以来培ってきたノウハウを最大限活かし、多様なお客様のニーズに応える製品の開発・製造を行っています。





精密加工ツールの増産へ向けて

半導体用途の拡大を受けて、精密加工ツールビジネスは今後も堅調な伸びが期待されています。また、新しい半導体素材の出現や加工技術の複雑化により、新たな精密加工ツールへのニーズが増えています。ディスコではこうした需要の伸びに対応するため、広島県呉市にある精密加工ツールの工場の一部の建物を取壊し、新棟を建てることを決定しました。

世界中のお客様への安定的な製品供給を実現するため、この新棟は地震被害を低減する免震構造を採用します。2007年末の完成時には、生産能力は現在より50%アップする予定です。

呉工場 精密加工ツール新棟



特徴

精密加工ツールの需要に先行対応

現行の約50%の生産能力増強

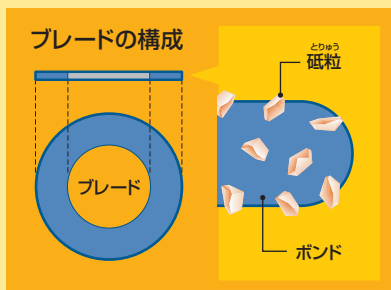
免震構造

投資総額:18億円

2007年末
完成予定

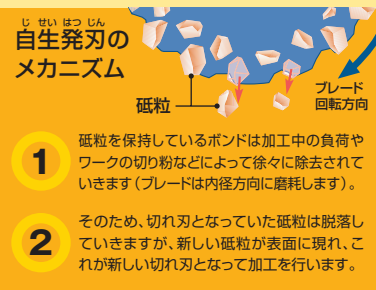
【ブレードの特徴】

ブレードは主に砥粒とボンドで構成されています。砥粒は実際に加工を行う切れ刃の役割を持っており、ボンドは砥粒を保持する役割を持っています。



【砥石のメカニズム】

ブレードは、一般の切削工具とは異なり、自生発刃作用と呼ばれる特殊な加工性能があります。これは、加工中に新しい砥粒が現われ、常に良好な切れ刃の状態を維持する作用です。



今期のDISCOを振り返ります。

企業説明会開催

当社は、6月の定時株主総会后に企業説明会を実施いたしました。法令に基づく開催である株主総会に加え、株主の皆様当社理念、企業文化、事業・技術概況などについて理解を深めていただきたいという主旨で、平成14年3月期より継続的に開催しています。さらにこの数年は、当社の技術を実際に目で見て感じていただくために開発施設見学会も併催しています。

速報開示

半導体・電子部品業界は市場の動きが激しく、環境は日々刻々と変化します。このような環境においてステークホルダの皆様リアルタイムに情報提供を行うため、平成18年4月より、単体・連結の売上高・利益の見通し数値が判明した時点で速報として開示しております。

当社は今後とも、法令や東京証券取引所の適時開示規則に則り適時・正確・公正な情報開示に努めてまいります。

注：速報値は会計監査人による監査前情報であるため、決算発表時に変更される可能性があります。

大型設備投資

将来の事業環境を見据え、当社は3つの大きな設備投資を決定いたしました。多様化するお客様のニーズへの対応として本社・R&Dセンタを拡張。また、半導体生産量の増加に対応するため、精密加工ツールおよび精密加工装置の生産能力向上を目的に呉工場と桑畑工場の一部建て替えを行います。この設備投資は、2004年度に実施した現本社・R&Dセンタ取得以来の大きな投資となります。



本社・R&Dセンタ（東京都大田区）

投資額：75億円 完成予定：2008年末

精密加工ツール工場（広島県呉市）

投資額：18億円 完成予定：2007年末

精密加工装置工場（広島県呉市）

投資額：19.5億円 完成予定：2007年末

SiP技術の進化で身近なツールをもっと薄く

伸長するNAND型フラッシュメモリ市場

ITバブル崩壊と言われた2001年以降の半導体市場は、短期的調整はありつつも堅調な成長を遂げています。

この成長はパソコン、携帯電話、デジタル家電といった半導体の搭載される最終製品市場の堅調な伸びによるところが大きいですが、もうひとつ忘れてならないのがNAND型フラッシュメモリに代表される半導体メモリ市場の伸びです。

NAND型フラッシュメモリは小型で大容量であるという特徴を活かし、MP3などの音楽プレーヤーや携帯電話、デジタルカメラに搭載されており、今後もモバイルPCやゲーム機器などに活躍の場を広げることが確実視される成長著しい半導体デバイスです。

例えば携帯電話ではカメラ機能付きが普及していますが、画像を取り込む際、大容量のデータを保存する必要があるため、NAND型フラッシュメモリが多く搭載されます。このような新たな市場ニーズの拡大のほかに、従来の記憶装置、ハードディスクドライブ（HDD）の代替という大きな市場の獲得が期待されています。

NAND型フラッシュメモリ市場は2002年から2005年にかけて約5倍に伸びており、半導体市場全体の約2倍の伸びを大きく凌駕しました。また2005年から2008年にかけては約2倍の成長が期待されています。

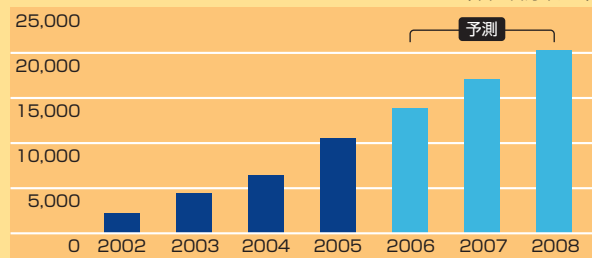
2005年時点では半導体市場に占めるNAND型フラッシュメモリ市場の割合はまだ約5%ですが、今後数年、半導体市場の成長を牽引していくことは明らかです。

この市場の伸張にあわせ、半導体メーカは大型の設備投資を実施または計画しています。当社もSiP（System in Package）技術の一つであり、当社のコア技術である薄化・ストレスリリーフ技術を通じて、フラッシュメモリ市場の成長に貢献していきます。



◎NAND型フラッシュメモリ市場の推移

（単位：百万米ドル）



出所：WSTS

DISCO Technology



DGP8760+DFM2700

DGP8760 ウェーハ薄化への挑戦

ウェーハの薄化ニーズに向けて

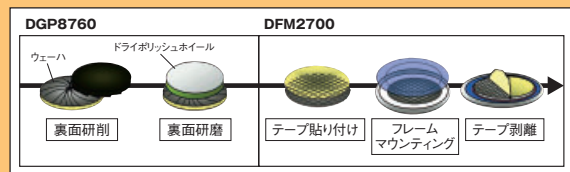
小型、大容量化が進むNAND型フラッシュメモリに代表される半導体メモリ市場の拡大に伴い、SiP (System in Package) 技術が脚光を浴びています。

SiP技術の要素は多岐にわたりますが、ディスコではシリコンウェーハの薄化技術を通じて市場に貢献しています。

直径300ミリのシリコンウェーハの加工前の厚みは800マイクロメートル程度ですが、薄化を施すウェーハでは、表面に回路パターンを作り込んだ後に、裏面を1ミリメートルの十分の一となる100マイクロメートル以下の薄さまで研削、研磨する必要があります。量産されている最薄ウェーハ、チップは現状70マイクロメートル程度ですが、近い将来には50マイクロメートルの量産も見込まれています。

しかし一言に薄化と言っても、加工後のウェーハ強度、加工にかかるコストなど、お客様の要望によってその加工方法は多岐にわたります。当社では、難度の高い研削・研磨加工への対応のみならず、搬送中のウェーハ破損リスクへの対応を含め多様なソリューションをお客様に提供しています。

◎DGP8760+DFM2700による薄化プロセス



インラインシステム需要に応え薄化をサポート

ウェーハ薄化ニーズに向けた当社の主力は、300ミリウェーハ対応のグラインダ（研削）とポリッシャ（ストレスリリーフ）一体の「DGP8760」と、全自動マルチウェーハマウンタ「DFM2700」を接続したインラインシステムです。

DGP8760は、様々な精密加工ツールとの組合せでおお客様の要求に応じた最適なウェーハ薄加工を可能にしています。またDFM2700は、薄化されたウェーハへの保護テープ貼り付け、剥離など必要な処理を施します。

薄く加工されたシリコンウェーハはその薄さのためたわみが発生し、割れ、破損のリスクと隣り合わせです。

一連の工程に人手を介すことのないインラインシステムは、お客様からの評価が非常に高い有効なソリューションです。

ウェーハ薄化に伴う問題の解決例「搬送システムの改善」

シリコンを薄く削っていくと、従来の装置ではシリコンの搬送時に左の写真のようなたわみが生じてしまいます。

ディスコでは、シリコンを支えるパッドをシリコンと同じ大きさにする「同一径搬送パッド」を自社開発し、こうしたたわみをなくしています。



果てしなき領域への挑戦

年間2,500件以上の加工相談に潜む「成長の種」

「半導体製造装置企業のディスコ」。

当社はこのように表現をされることが多くありますが、はたして実態はどうでしょうか？

ディスコの2006年度中間決算値を見てみると確かに売上高の約95%を半導体向けを中心とする電子業界関連製品向けが占めますし、売上高の推移と半導体市場の成長の間にかかなりの相関もあります。世界中の半導体メーカーと強固な信頼関係で結ばれ、次世代技術開発を共にやっているのも事実です。

このような視点から見ると「半導体製造装置企業のディスコ」という表現は実態を表していると言えます。

ただ、ディスコではこれをちょっと違った見方で捉えています。

「ディスコの高度なKiru・Kezuru・Migaku技術が求められる市場で事業を展開する」。

市場があるから事業進出するのではなく、1970年代にディ

スコが半導体市場へ本格参入した時のように、誰にも真似のできないレベルの技術をもつことが活躍の場（市場）を広げることにつながるはずです。

当社の加工相談窓口であるアプリケーションラボラトリには「Kiru・Kezuru・Migaku」に係わる年間約2,500件の加工相談が持ち込まれます。そのほとんどは半導体関連の加工相談ですが、中には全く別の市場からの相談もあります。

あらゆる市場からの相談に対してソリューションを提供し続けることが、ディスコのオンリーワンの技術を研ぎ澄ますことにつながり、そして新たな市場との関係をスタートさせるのです。

ディスコはこれからも「Kiru・Kezuru・Migaku」にこだわり続けることで、新たな市場を開拓していきます。

今日もアプリケーションラボラトリには、加工相談という「成長の種」が寄せられています。



Financial Statements

中間連結財務諸表(要旨)

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	第67期中間 平成17年 9月30日現在	第68期中間 平成18年 9月30日現在	第67期通期 平成18年 3月31日現在
資産の部			
流動資産	53,020	68,170	64,279
固定資産	33,452	36,482	35,039
有形固定資産	28,921	29,555	29,057
無形固定資産	380	912	758
投資その他の資産	4,151	6,014	5,223
資産合計	86,473	104,652	99,318
負債の部			
流動負債	16,244	24,456	25,493
固定負債	12,606	3,076	3,123
負債合計	28,850	27,532	28,617
少数株主持分	328	-	424
資本の部			
資本金	9,885	-	13,412
資本剰余金	10,967	-	14,494
利益剰余金	36,450	-	41,899
その他有価証券評価差額金	200	-	303
為替換算調整勘定	△178	-	205
自己株式	△31	-	△39
資本合計	57,294	-	70,276
負債、少数株主持分及び資本合計	86,473	-	99,318
純資産の部			
株主資本			
資本金	-	14,392	-
資本剰余金	-	15,474	-
利益剰余金	-	46,194	-
自己株式	-	△49	-
株主資本合計	-	76,013	-
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	-	239	-
為替換算調整勘定	-	428	-
評価・換算差額等合計	-	668	-
新株予約権	-	9	-
少数株主持分	-	428	-
純資産合計	-	77,120	-
負債、純資産合計	-	104,652	-

中間連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	第67期中間 自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	第68期中間 自平成18年4月1日 至平成18年9月30日	第67期通期 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
売上高	28,868	39,825	68,885
売上原価	13,943	18,711	32,734
販売費及び一般管理費	10,333	11,523	22,201
営業利益	4,591	9,590	13,949
営業外収益	322	178	590
営業外費用	85	255	129
経常利益	4,828	9,513	14,410
特別利益	0	27	16
特別損失	802	272	1,041
税金等調整前中間(当期)純利益	4,027	9,268	13,385
法人税、住民税及び事業税	1,801	3,742	5,077
法人税等調整額	△86	△73	18
少数株主利益	16	38	58
中間(当期)純利益	2,295	5,559	8,230

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	第67期中間 自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	第68期中間 自平成18年4月1日 至平成18年9月30日	第67期通期 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,734	4,407	12,322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,400	△3,714	△4,409
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,601	△1,529	△3,031
現金及び現金同等物に係る換算差額	104	88	230
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	△163	△747	5,111
現金及び現金同等物の期首残高	16,891	22,003	16,891
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	16,728	21,255	22,003

2006年5月1日施行の会社法により、「少数株主持分」「資本の部」が廃止され、「純資産の部」が新設されました。

これは貸借対照表上、資産性を持つものを「資産の部」、負債性を持つものを「負債の部」に記載し、それらに該当しないものを資産と負債の差額として「純資産の部」に記載するものです。

これにより、会社の支払能力などの財政状態をより適切に表示することが可能となります。

新設

「中間連結株主資本等変動計算書」について

2006年5月1日施行の会社法に伴い、「連結株主資本等変動計算書」が新設されました。これは、左ページの「中間連結貸借対照表」で新設された「純資産の部」の中で、主に株主の皆様へに帰属する株主資本等について、その1会計期間における変動事由と変動額をご報告するために作成する計算書類です。

ここでは、その内訳「株主資本」等の変動について図解とともにご説明します。

中間連結株主資本等変動計算書

第68期中間（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

科 目	株 主 資 本					評 価 ・ 換 算 差 額 等			新株予約権	少 数 株 主 持 分	純 資 産 合 計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	為替換算調 整勘定	評価・換算差 額等合計			
平成18年3月31日 残高	13,412	14,494	41,899	△39	69,767	303	205	509	-	424	70,701
当中間期中の変動額											
新株の発行	980	980			1,960						1,960
剰余金の配当			△1,174		△1,174						△1,174
利益処分による役員賞与			△90		△90						△90
中間純利益			5,559		5,559						5,559
自己株式の取得				△10	△10						△10
株主資本以外の項目の当中間期中の変動額（純額）						△63	222	159	9	4	173
当中間期中の変動額合計	980	980	4,295	△10	6,245	△63	222	159	9	4	6,418
平成18年9月30日 残高	14,392	15,474	46,194	△49	76,013	239	428	668	9	428	77,120

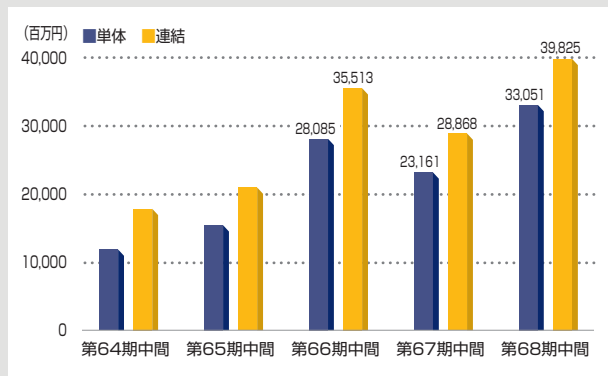
自己株式		△31	-	△39
資本合計	57,294	-	-	70,276
負債、少数株主持分及び資本合計	473	-	-	99,318
純資産の部				
株主資本				
資本金	-	14,392	-	-
資本剰余金	-	15,474	-	-
利益剰余金	-	46,194	-	-
自己株式	-	△49	-	-
株主資本合計	-	76,013	-	-
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	-	239	-	-
為替換算調整勘定	-	428	-	-
評価・換算差額等合計	-	668	-	-
新株予約権	-	9	-	-
少数株主持分	-	428	-	-
純資産合計	-	77,120	-	-
負債、純資産合計	-	104,652	-	-

（単位：百万円）

Financial Data

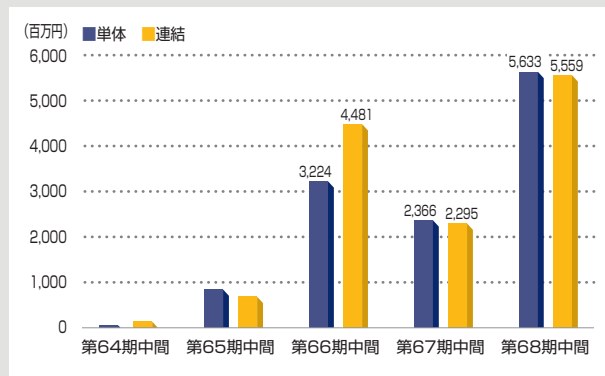
財務指標（連結）

◎売上高



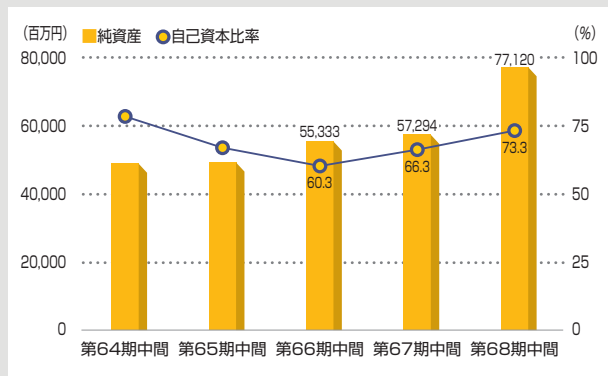
半導体の需要拡大に伴う半導体メーカーの設備投資の増勢を受けて、精密加工装置、精密加工ツールともに売上が伸び、連結売上高は前年同期比38.0%増加して398億25百万円となりました。

◎中間純利益



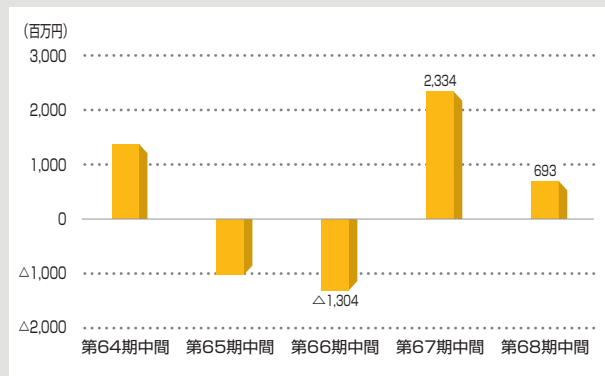
前年同期比32億64百万円の増益となりました。対売上高純利益率は、前年同期比6.0ポイント増加して14.0%となり、引き続き高い利益率を維持しました。

◎純資産・自己資本比率



純資産は、新株予約権付社債の償還による資本金の増加および利益剰余金の増加に伴い、前年同期比193億87百万円増加しました。よって自己資本比率は前年同期の66.3%から73.3%と7.0ポイント増加しました。

◎フリーキャッシュ・フロー



売上高の増加に伴い、営業活動の結果得られた資本は増加しましたが、投資活動により使用した資金も増加したため、前年同期比16億40百万円減少して6億93百万円となりました。

Questionnaire Result

株主アンケート結果

第67期事業報告書で実施させていただきましたアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございます。1,070件のご回答をいただき、回答率は8.4%に達することができました。

たいへん多くの株主の皆様にご回答いただきましたことに対しまして、厚くお礼申し上げますとともに、ここにアンケートに寄せられた皆様のご質問の中から以下2問についてご回答させていただきます。

Q 株主優待は実施しないのですか？

A

ご意見をいただきましたとおり、現在多くの企業が株主優待を実施しています。その目的は、顧客に株主になっていただくといったものや、株主数増加への期待というケースが多いようです。

これはこれでひとつの考え方であろうと思いますが、当社は配当を株主の皆様への還元策の基本と考えており、株主優待を実施する考えは持っておりません。

なお、2006年3月期より配当性向を連結当期純利益の20%の業績連動型としました。また3期連続で連結純利益が赤字になった場合を除き、業績低迷時でも1株当たり年間20円の配当を維持します。これにより長期に保有していただく株主の皆様のご期待にお応えできると考えております。

Q

業績が低迷した場合、利益配分や研究開発費および設備投資とのバランスをどのようにとりますか？

A

利益還元と将来に向けた投資のバランスをどのように考えているかというご質問かと思えます。

当社は利益の20%を株主配当に、80%を内部留保や将来の成長に向けた投資に振り向けることを基本的な考えとしています。将来の成長に向けた投資は、①人的資源への投資、②新規技術開発のための研究開発投資、③製造工場などへの設備投資、④他社との提携・M&A投資に大別することができます。

これらの配分は都度状況を見極めつつフレキシブルな対応を心がけておりますが、特に、研究開発投資は業績低迷時においても一定の水準を維持し、次の成長につながることを重視しています。

紙面の関係上一部のご質問にしか回答できず申し訳ございません。

当社ホームページに、その他の結果について掲載しております。ぜひご覧ください。(http://www.disco.co.jp/jp/ir/answer/index.html)
今後も、株主の皆様のご意見を経営に活かしていきたいと考えておりますので、アンケートへのご意見、ご協力のほど、何卒よろしくお願いたします。

DISCO Information

会社情報および株式の状況 (2006年9月末日現在)

■ 会社概要

本社所在地 東京都大田区大森北二丁目13番11号

創業年月日 1937年5月5日

設立年月日 1940年3月2日

資本金 14,392百万円

従業員数 1,310名

主な事業内容

- 精密加工装置
 - 製造および販売
 - メンテナンスサービス
 - オペレーションやメンテナンスの研修サービス
 - 解体リサイクル事業
 - リースおよび中古品販売
- 精密加工ツール
 - 製造および販売
 - 精密部品の有償加工サービス

事業所 本社・R&Dセンター
広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場)

国内拠点 大阪支店、九州支店、仙台支店、
名古屋営業所、諏訪営業所

■ ディスコグループ関連会社

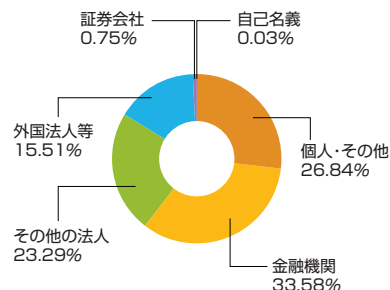
国内法人 株式会社テクニスコ
株式会社ディスコ アプレイシブ システムズ
株式会社ディーエスティ
株式会社ディーエスティ九州
株式会社ダイイチコンポーネッツ

海外法人 DISCO HI-TEC AMERICA, INC.
DISCO HI-TEC EUROPE GmbH
DISCO HI-TEC FRANCE SARL
DISCO HI-TEC U.K. LTD.
DISCO HI-TEC MOROCCO SARL
DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD
DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD.
DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD.
DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
JETSIS INTERNATIONAL PTE LTD
DD Diamond Corporation
S.E.A. Utensili Diamantati S.p.A.
DISCO-SEA AMERICA, INC.
TECNISCO (Suzhou) Co., Ltd
DHK Solution Corporation

■ 役員

名誉会長……………関家 憲一
(取締役・監査役)
代表取締役社長…溝呂木 斉
常務取締役……………関家 圭三
関家 一馬
取締役……………関家 英之
梶山 啓一
溝呂木 隆夫
田村 隆夫
常勤監査役……………玉利 晋
古川 深志
監査役……………浅海 芳久
木谷 孟
(執行役員)
荒井 一尚
吉永 晃

■ 所有者別株式数分布状況



■ 株式概要

上場証券取引所 東京証券取引所第一部上場(証券コード6146)

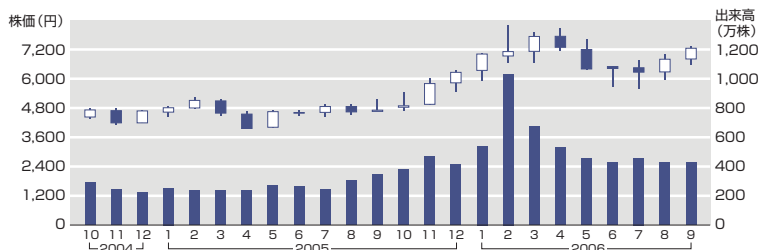
発行済株式総数 33,946,518株

株主数 13,851名

大株主

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	4,529千株	13.34%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2,838千株	8.36%
株式会社ダイイチ企業	1,998千株	5.89%
株式会社ダイイチホールディングス	1,998千株	5.89%
株式会社OCTAGON LAB	1,704千株	5.02%
関家 臣二	1,348千株	3.97%
関家 憲一	1,036千株	3.05%
資産管理サービス信託銀行株式会社	960千株	2.83%
株式会社オレンジコーラル	846千株	2.49%
日本生命保険相互会社	794千株	2.34%

■ 株式チャート



DISCO Story..... 3

〈1976年～1992年〉

【全6回シリーズ】

順調な業績拡大の光と影。

シリコンサイクルに負けるな！

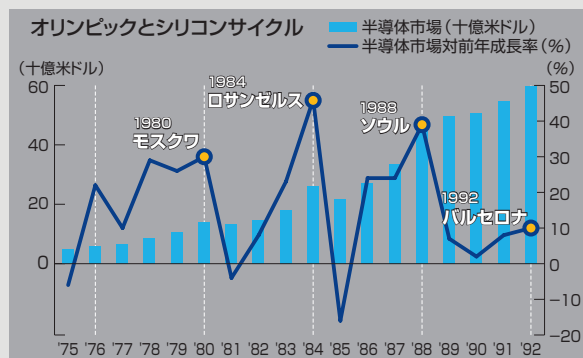
1975年のセミコンウエストでの成功の後、現在のダイシングソーの原型である「DAD-2H」はその頑丈さと高い性能が評判を呼び、世界中の半導体メーカーから次々と注文が入るようになりました。当時はテレビや、家電製品などの機能が向上し始め、これに伴って半導体の需要が急速に増加した時期であり、需要に供給が追いつかないほどディスコの装置が引く手あまたとなったのです。これに対応すべく、ディスコは海外での販売・サービス拠点を次々と立ち上げていきます。

その頃、世界規模で半導体市場に不思議な現象が起きていました。オリンピックが開催される年の前後にピークを迎えた需要が、その後一気に落ち込み、また4年後を目処に上昇するという「シリコンサイクル」です。しかし、ディスコはこの環境をものともせず、1985年には売上高が10年前のなんと10倍にまで達し、順調に業績を拡大していきました。これは、既存の技術に甘んじることなく、顧客のニーズに合わせて次々と既存技術に改良を加えて製品化していっただけでなく、アフターサービスを他社に先駆けてグローバルレベルで実践してきたことも大きな理由です。

【用語】シリコンサイクル

半導体業界において3～5年周期で訪れる好不況の景気サイクル。

半導体需要が供給を上回ると価格は上昇、メーカーは設備投資を行い供給を増やす。その結果、供給過多となり価格が下落しメーカーは設備投資、生産量を調整する。歴史的にはオリンピック開催年にサイクルのピークが来ることが多い。



ディスコはフィールドをさらに広げようと考え、1983年にヨーロッパの企業と提携して、半導体製造の一工程である縦型酸化・拡散装置の開発に乗り出します。この分野は砥石の技術をベースに成長してきたディスコにとっては未開拓の分野です。

それでも当時、機械装置ビジネスの成功体験をもとにディスコは、既存の事業を拡大しながらもこの分野の開発を続けます。しかし1986年にはこの開発投資の負担もあって業績が著しく悪化。初めてシリコンサイクルの「谷」を味わうこととなります。一時的に業績は回復しますが、やはりシリコンサイクルの波には勝てず、とうとう1992年には創業以来初の6億円の経常損失を計上し、この事業からの撤退を決断しました。

さらに、新規分野への挑戦は思わぬ苦悩を生みました。限られた人的資源を新規分野へ投入し続けた結果、半導体切断装置は競合企業の台頭もあり、その競争力にかげりが出始めたのです。崖っぷちから這い上がるための唯一の方法は、競争力のある装置の市場投入です。

半導体切断装置の成功、新規分野への参入、1989年の株式店頭公開。傍目には順風に見える中にも光と影があったのです。

新規分野からの撤退決断を下す少し前、決して失敗の許されない開発プロジェクトがスタートしました。

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当金 受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年9月30日
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日とします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 (同送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-7111 (フリーダイヤル)
同取次所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国本支店
公告方法	電子公告（当社のホームページに掲載します） ただしやむを得ない事由により電子公告ができないときは 日本経済新聞に掲載します。
証券コード	6146

さらに詳細なIR情報は こちらからどうぞ。

当社では、株主や投資家の皆様向けにIRサイトを設けております。株価や株式に関するお手続きなどのお知らせのほか、IR関連のお知らせを最新のものから過去5年にさかのぼって検索できる「IRニュース」や株主総会などのスケジュールを掲載した「IRカレンダー」などコンテンツを充実させております。どうぞお気軽にアクセスしてみてください。

<http://www.disco.co.jp/>

〈株主・投資家情報〉ページ



“Cutting Edge” とは...

Cutting Edgeとは、辞書で引くと「刃の先端」という意味のほかに、「最先端」という意味があります。ディスコグループの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」という企業ミッションをより深くご理解いただくために、常に最先端の技術を保有しながらも、社会に積極的に貢献していきたいという願いをこのタイトルに込めました。

これからも、ディスコグループの最先端の技術情報とともに、報告内容を充実してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



株式会社 ディスコ

143-8580 東京都大田区大森北 2-13-11
<http://www.disco.co.jp/>

2100

古紙(リサイクル)配合率100%再生紙を
使用しております。



環境に優しい植物性大豆油インキを
使用しております。